

8月市场洞察报告

半导体市场分析与趋势展望

“DISTINCTIVE
INSIGHTS,
INFORMED
DECISION-MAKING”

洞察行情 精准决策

序言

本报告由安芯易电子商务（深圳）有限公司推出，旨在为客户、供应商及合作伙伴提供半导体行业资讯及市场趋势预测，报告涵盖宏观动态、半导体产业动态、终端市场动态、重点产品行情等模块，助力行情洞察、精准决策。

本报告每月更新，可关注安芯易电子微信公众号，及时获取报告发布等信息。您也可以通过联系安芯易客户经理获取完整版报告。

目录

摘要.....	4
一、宏观动态.....	5
二、半导体产业动态.....	8
三、 终端市场动态.....	15
（一） 人工智能.....	15
（二） 汽车.....	16
（三） 机器人.....	17
（四） 工业.....	17
四、 存储行情.....	18
（一） 存储行情概览.....	18
（二） 存储品类/品牌现货市场价格趋势.....	18
信息来源.....	22
免责声明.....	25

摘要

2026 年 8 月重点行情趋势	
宏观动态	● 世界半导体贸易统计组织：2026 上半年全球半导体市场增长 102% ● 全球/亚洲制造业：AI 带动亚洲制造业与电子出口回升 ● 中国制造业：8 月 PMI 49.8，高技术制造 PMI 52.9，电子设备产需指数>53 ● 韩国半导体出口：8 月半导体出口创历史新高，验证 AI/Memory 真实需求 ● 美国贸易政策：半导体供应链本土化和关税风险继续强化
产业动态	● 意法半导体：五个月内三度涨价，MCU 现货上涨 29% ● 恩智浦：汽车 MCU 持续紧张，RFID 两月两涨 ● 微芯科技：8 月 14 日部分产品线调价正式生效 ● 德州仪器：12 个月五轮调价，AI 紧缺型号最高涨 85% ● 亚德诺：9 月 13 日第二轮涨价，涨价绑定扩产 ● 三星电机：MLCC 统一涨价 30%，已签长协锁定供货至 2027 ● 台积电：CoWoS 产能告急，订单外溢至英特尔，与索尼合资建厂 ● 中芯国际：Q2 营收首破 30 亿美元，AI 需求驱动量价齐升 ● 英伟达：Q2 营收 962 亿美元同比翻倍，Q3 指引首破千亿，Groq 3 量产 ● 瑞萨电子：熊本地震余波持续，光电耦合器与车规 MCU 生产受限 ● SK 海力士：美国工厂 2029 年 Q3 量产 HBM4E，CEO 预测供不应求持续至 2030 年底
终端市场	人工智能 ● 四大科技巨头 AI 基建投资近 2.4 万亿美元 ● 2026 年九大 CSP 资本支出将大涨 90%，AI 服务器出货将增长 31% ● CoreWeave 资本支出上调至 350-390 亿美元，印尼建 360MW 数据中心 汽车 ● 特斯拉 Megapack 3 量产下线，德州超级工厂年产能 50GWh 机器人 ● 小鹏 IRON 年底量产，2027 年零售与服务发售 ● 优必选与基本半导体合作 SiC，开发电源与运动控制 工业 ● 西门子投 2 亿美元在美新建两厂，扩产 AI 电力设备
存储行情	● DRAM：TrendForce 预计 Q3 传统 DRAM 合约价环比上涨 13%至 18%，而摩根士丹利、瑞银等外资行预测 Q3 涨幅可达 20%至 32% ● DDR3：延续供应紧张态势，价格持续上行，但现货涨幅已有所放缓 ● DDR4：合约走强（Q3 或涨约 50%），部分现货已出现松动回调

● DDR5：受成本与云采购双驱动，价格维持高位 ● HDD：AI 存储需求推动价格持续上行，供应缺口预计延续至 2028 年
--

一、宏观动态

● 世界半导体贸易统计组织：2026 上半年全球半导体市场增长 102%

世界半导体贸易统计组织 2026 年第二季度数据，上半年全球半导体市场达 7020 亿美元，同比猛增 102%，主要受 AI 基础设施、高性能计算及先进内存驱动。内存产品增长 305%，逻辑增长 45%。基于 Q2 实际数据，全年预估上调至 1.655 万亿美元，同比增长约 108%，较春季预测高出 18 个百分点；2027 年预估约 2.1 万亿美元，增长约 29%。内存全年预计增长 302%，所有主要区域均扩张，美洲和亚太继续引领增长。高速增长之下，最新一期全球芯片供应商 TOP20 榜单也正式揭晓，内存公司环比增幅领先：铠侠+76%、SK 海力士与闪迪+51%；英伟达环比+18%，博通预测+33%。铠侠（第 8）、闪迪（第 9）排名上升，收入同比均增四倍以上。其余 20 大供应商 Q1 至 Q2 仅增长 9%，分化显著。

Top Semiconductor Companies' Revenue					
Change versus prior quarter in local currency					
	Company	US\$B 2Q26	Reported 2Q26	Guidance 3Q26	Comments on 3Q26
1	Nvidia	96.2	18%	12%	AI demand remains strong
2	Samsung SC	83.2	62%	n/a	strong AI memory demand
3	SK Hynix	51.8	51%	n/a	strong AI memory demand
4	Micron	41.5	74%	21%	supply constraints
5	Broadcom	29.4	33%	n/a	3Q26 is 2Q26 guidance
6	Intel	16.1	19%	1.1%	supply constraints
7	AMD	11.5	13%	13%	data center strong
8	Kioxia	11.0	76%	35%	strong AI memory demand
9	Sandisk	9.0	51%	18%	supply constraints
10	Qualcomm IC	8.5	-6.3%	2.3%	mobile phones weak
11	TI	5.5	13%	8.0%	all markets strong
12	Infineon	4.8	9.4%	13%	AI & auto strong
13	MediaTek	4.8	2.0%	2.5%	mobile phones weak
14	ADI	4.0	11%	6.9%	AI data center strong
15	NXP	3.5	10%	7.3%	auto strong
16	STMicro	3.5	13%	6.1%	AI data center strong
17	Sony Imaging	3.2	-2.2%	n/a	mobile image sensors down
18	Marvell	2.7	12%	n/a	3Q26 is 2Q26 guidance
19	Renesas	2.6	10%	2.8%	auto flat, IoT up
20	Onsemi	1.6	6.0%	6.0%	AI data center strong
Total of above		394	33%		
AI companies		322	40%		Nvidia, Broadcom & memory
Others		72	9%	6%	

(图片来源 Semiconductor Intelligence)

- **全球/亚洲制造业：AI 带动亚洲制造业与电子出口回升**

路透社 9 月 1 日公布的一项调查显示，全球对人工智能硬件的强劲需求，使亚洲工厂在 2026 年 8 月保持扩张态势。具体数据方面，中国 8 月制造业 PMI 升至 51.5（标普全球调查 PMI），高于 7 月的 50.9 和市场预期的 51；日本 PMI 升至 54.9，为 4 月以来最高，连续第八个月扩张；韩国 PMI 虽小幅回落至 52.3，但已连续第九个月处于扩张区间。韩国的扩张主要由出口驱动，当月出口同比增长 68.7%，连续 15 个月正增长。此外，中国台湾、马来西亚和菲律宾的工厂活动同样扩张，其中菲律宾 PMI 大幅跳升至 54.9。标普全球市场财智经济学家指出，出口需求的强劲增长是一个“令人振奋的信号，表明企业仍能从当前的 AI 和半导体超级周期中受益”。

- **中国制造业：8 月 PMI 49.8，高技术制造 PMI 52.9，电子设备产需指数>53**

2026 年 8 月 31 日，国家统计局发布 PMI 数据，首席统计师霍丽慧解读。8 月制造业 PMI 为 49.8%，较上月回升 0.6 个百分点，21 个行业中 16 个改善，景气明显回升。产需两端同步扩张，生产指数 50.4%（+0.5），新订单指数 50.6%（+2.1），采购量指数 50.5%（+1.1）。其中，电气机械器材、计算机通信电子设备等行业生产指数和新订单指数均高于 53.0%，产需较快释放；而化学原料、黑色金属等行业仍低于临界点。装备制造业（51.4%）和高技术制造业（52.9%）持续扩张，消费品（49.0%）和高耗能行业（47.9%）景气回升。价格指数双双上行，购进价格 56.6%（+3.4），出厂价格 50.4%（+2.6）重返扩张区间。大型企业 PMI 升至 50.6% 进入扩张，中型 49.4% 回落，小型 47.9% 回升。非制造业商务活动指数为 49.0% 持平。服务业 49.3% 持平，邮政、电信、互联网等业务增长较快，批发零售偏弱；建筑业 46.9% 微降，受暴雨台风影响。综合 PMI 产出指数为 49.5%，上升 0.2，经济总体产出景气水平略有改善。

● 韩国半导体出口：8月半导体出口创历史新高，验证 AI/Memory 真实需求

韩国产业通商资源部 9 月 1 日发布的数据显示，2026 年 8 月韩国半导体出口额达 466.5 亿美元，同比暴增 209%，创下历史新高。这已是韩国半导体出口连续第三个月突破 400 亿美元。受此强劲拉动，韩国 8 月总出口额达 982.5 亿美元，同比增长 68.7%，为历史单月第三高。其中，半导体出口占当月出口总额的 47.5%，贡献了当月近八成的出口增量。此次出口激增，被市场普遍视为 AI（人工智能）与高附加值存储芯片（Memory）真实需求的强力验证。分析指出，全球 AI 基础设施投资持续扩大，谷歌、亚马逊等科技巨头对高带宽内存（HBM）等高性能芯片的需求激增，是推动出口创新高的核心动力。此外，受企业级固态硬盘（SSD）核心部件 NAND 价格上涨等因素带动，韩国 8 月计算机出口额也同比大增 419.5%，达 62.4 亿美元，同样创下单月历史新高。

● 美国贸易政策：半导体供应链本土化和关税风险继续强化

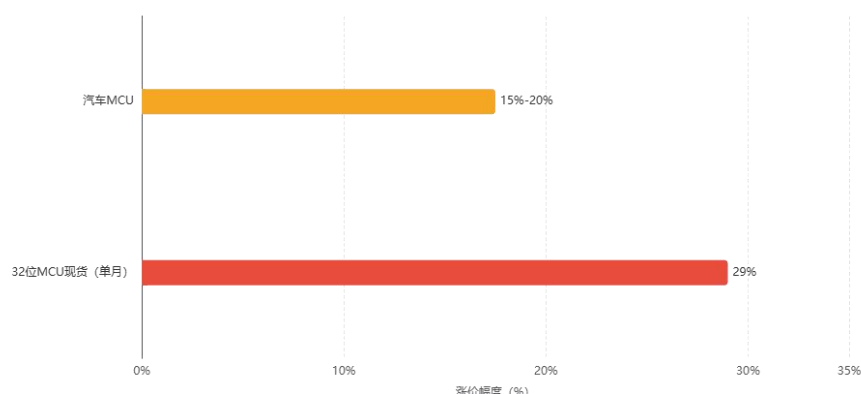
8 月，美国半导体供应链“本土化+关税”双线进一步强化，政策工具从早期的出口管制延伸至上游原材料与制造环节。当地时间 8 月 6 日，美国总统特朗普签署行政令，依据《1962 年贸易扩展法》第 232 条，对进口多晶硅及其衍生产品采取最低进口价格和额外关税措施，以支持美国国内多晶硅、半导体和太阳能供应链。公告规定，最低进口价格分别为：多晶硅每公斤 21 美元；多晶硅锭和晶圆每公斤 100 美元；太阳能电池每瓦 0.22 美元；太阳能组件每瓦 0.38 美元。同时，美国将对公告附件所列多晶硅锭及相关衍生产品加征 15% 的从价关税。相关措施将自 2026 年 12 月 4 日美国东部时间凌晨 12 时 01 分起生效。此外，美国商务部还被授权设立“回流美国”激励计划，对承诺在美投资建设多晶硅、硅片、电池或组件生产设施的企业给予关税减免。

二、半导体产业动态

半导体产业动态概览			
厂商	类别	核心数据	趋势
意法半导体 ST	MCU/功率	32 位 MCU 现货价+29%；车规 MCU+15%-20%；功率器件交期 30-52 周	三度涨价、供给趋紧
恩智浦（NXP）	MCU/汽车处理器/RFID	S32/S32K 系列交期偏长；RFID 芯片涨价累计 +8%-12%	涨价扩产、交期偏长
微芯（Microchip）	MCU/模拟/PMIC	ATmega/AVR/PIC18 交期 20-30 周；工业级、车规类热门料号交期 18-27 周	调价生效、供货紧张
德州仪器（TI）	模拟/PMIC/信号链	12 个月 5 次调价；AI 服务器紧缺型号最高 +85%；部分老旧料号+100%+	五轮调价、AI 紧缺
亚德诺（ADI）	模拟/信号链	Q3 营收 40.22 亿美元；同比增长 40%	二轮涨价、绑定扩产
三星电机（Samsung Electro-Mechanics）	被动元件	MLCC 8 月 1 日全系+30%；	MLCC 涨价、长协锁定供货至 2027
台积电（TSMC）	晶圆代工 / 先进封装	2026 年底 CoWoS 月产能~14 万片；订单排至 2027 年；2027 年代工价格基础涨幅 5%-10%	CoWoS 告急、扩产加码
中芯国际（SMIC）	晶圆代工	Q2 营收 30.06 亿美元环比 + 20% 首破 30 亿；毛利率 25.3%；产能利用率 93.7%；ASP 环比 + 5.7%	逼近满产、量价齐升
英伟达（NVIDIA）	GPU/AI 加速器	Q2 营收 962 亿美元同比 + 106%；数据中心 890 亿美元同比 + 117%；毛利率 75%；Q3 指引 1080 亿美元	AI 需求爆发、营收翻倍
瑞萨电子（Renesas）	功率/车规 MCU	熊本地震余波，光电耦合器产线停产或缓慢恢复，车规 MCU（RL78/RH850）订单大幅延期	地震扰动、供给承压
SK 海力士（SK Hynix）	存储	下一代高带宽内存（HBM）先进封装厂总投资超 40 亿美元；2029 年下半年量产 HBM4E	供不应求持续至 2030 年底

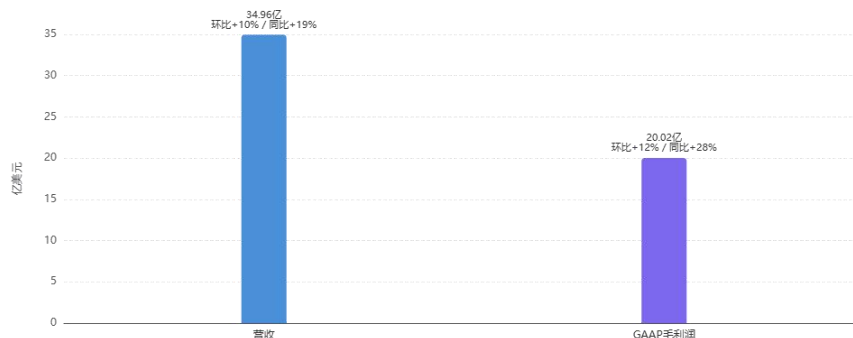
● 意法半导体：五个月内三度涨价，MCU 现货上涨 29%

8月23日，意法半导体启动近五个月内第三次涨价。32位 MCU 现货8月涨29%，汽车 MCU 涨15%~20%，功率器件交期普遍超30周，部分达52周，供应紧张可见一斑。涨价原因方面，ST 销售与市场部总裁在通知中指出，运输、能源、原材料及制造服务等全链条成本持续上涨；更深层因素在于公司正处于产线转换的关键窗口——碳化硅由6英寸转向8英寸、模拟制程由8英寸转向12英寸，新产能需经历验证、认证和逐步放量，短期有效供给受限。同时，工业客户因 MCU 设计导入后更换料号需重新验证甚至修改硬件，难以快速切换供应商，进一步放大了供需缺口。



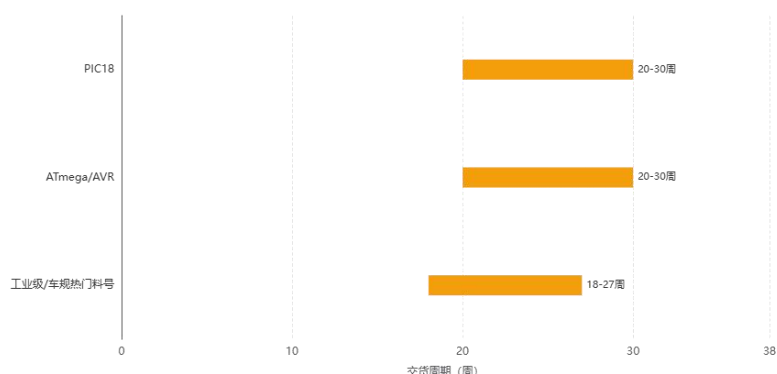
● 恩智浦：汽车 MCU 持续紧张，RFID 两月两涨

恩智浦 2026 年 Q2 营收 34.96 亿美元（同比+19%，环比+10%），GAAP 毛利润 20.02 亿美元（同比+28%，环比+12%）。汽车及工业 IoT 业务环比增长，渠道库存 11 周，S32/K 系列 MCU（尤其 S32K3/K144/K146）交货期仍长。RFID 芯片近两月累计涨价 8%-12%，主因高端芯片产能挤压中低端供给，且 ST 同步跟涨，反映行业性紧张。8月中旬推出首款集成 10BASE-T1S PHY 并支持后量子密码的 MCX A5 系列；8月12日马来西亚新封装测试厂动工，预计 2028 年 Q1 量产，全面投产后产能翻倍。



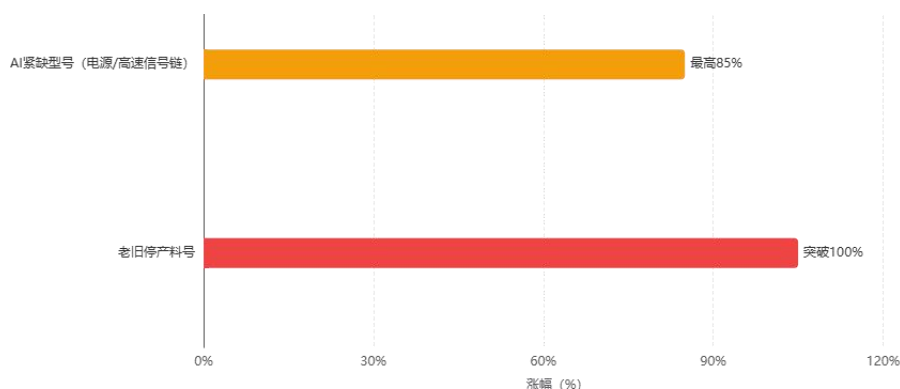
● 微芯科技：8 月 14 日部分产品线调价正式生效

微芯科技部分产品组合调价于 8 月 14 日生效，覆盖 MCU、存储、模拟及电源管理 IC 等核心产品线，主因晶圆、封装、原材料及人力等综合成本持续上升。工业级与车规类热门料号交期达 18-27 周，ATmega/AVR、PIC18 部分型号交货期达 20-30 周，供给持续偏紧。8 月 25 日，豪恩汽电与微芯达成技术合作，围绕 ASA-ML 生态推动标准化高速座舱及 ADAS 连接方案在中国及全球市场部署。



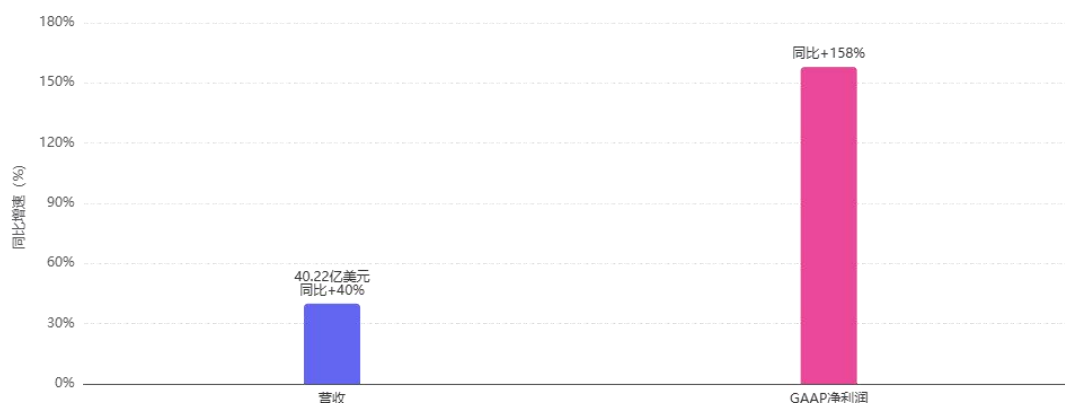
● 德州仪器：12 个月五轮调价，AI 紧缺型号最高涨 85%

德州仪器在过去 12 个月内已累计调价五次，2026 年 8 月再发通知，宣布自 10 月 1 日起上调部分产品价格，例外申请将极为有限。AI 服务器 PMIC 与高速信号链产品涨幅 15%-85%，部分停产料号涨幅超 100%。涨价主因系原材料、晶圆代工、封装及物流成本持续上行，叠加 AI、新能源汽车、储能等领域需求爆发，现有产能难以匹配。TI 八英寸晶圆产能持续吃紧，配额优先供给 AI 服务器、车规及工业头部客户，中小客户供货份额遭压缩，TPS、UCC、OPA、ISO 等系列供货紧张，现货市场价格波动剧烈。



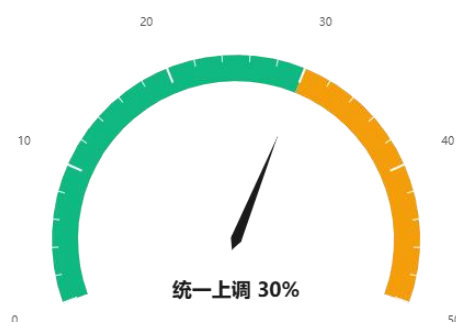
● 亚德诺：9 月 13 日第二轮涨价，涨价绑定扩产

ADI 于 8 月向全球合作经销商下发正式调价通知，全系产品将于 2026 年 9 月 13 日执行全新售价，这是企业本年度第二次大范围调价。首轮调价于 2 月 1 日生效，覆盖商用、工业级、军工全系列。与年初对冲通胀的被动调价不同，ADI 在客户函中明确将涨价收入与产能扩张绑定——调价所得全部再投资于内部晶圆厂与封测产线扩建，以缓解长达六个月的交期压力。8 月 19 日，ADI 公布 2026 财年第三季度财报，营收 40.22 亿美元，同比增长 40%，公司历史上首次单季突破 40 亿美元大关。GAAP 净利润同比增幅达 158%。



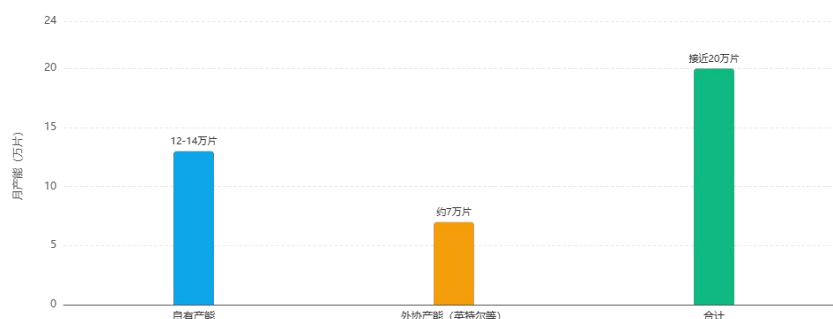
● 三星电机：MLCC 统一涨价 30%，已签长协锁定供货至 2027

三星电机自 2026 年 8 月 1 日起，将旗下全品类 MLCC 出货价统一上调 30%，覆盖消费电子、工控、汽车及 AI 服务器所有产品线。三星电机已与超过 10 家云厂商和半导体巨头签订长协，交货时程锁定至 2027 年。



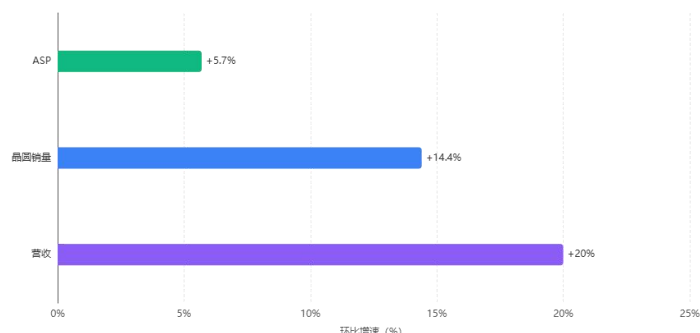
● 台积电：CoWoS 产能告急，订单外溢至英特尔，与索尼合资建厂

2026 年 8 月，台积电先进封装 CoWoS 产能严重供不应求，后段部分订单外溢至英特尔马来西亚厂协助。预计年底月产能达 12-14 万片，叠加外协接近 20 万片，但全年缺口仍存，订单已排至 2027 年，瓶颈主要在后段放量慢于前段。台积电 8 月 11 日批准与索尼合资，于日本熊本设立 Advanced Vision 半导体公司，索尼为单一控制股东。索尼注资 4650 亿、台积电 2820 亿日元，需日本政府支持，预计 2029 年量产智能手机图像传感器。此外，台积电已通知主要云服务商与网络设备客户，台积电计划 2027 年代工价格基础涨幅 5%-10%，预示基础 IC 与封装成本仍将保持上行。



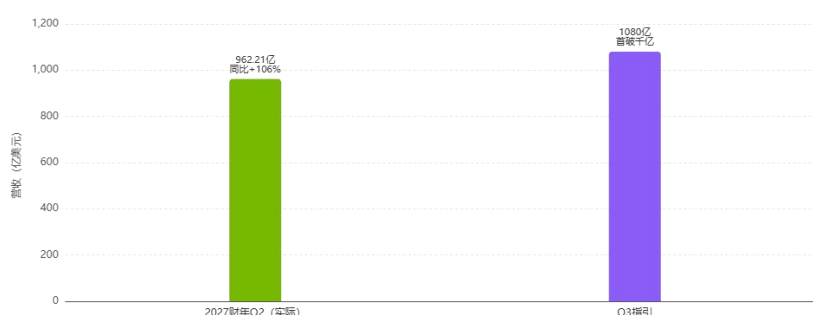
● 中芯国际：Q2 营收首破 30 亿美元，AI 需求驱动量价齐升

2026 年 8 月 13 日，中芯国际发布 Q2 财报，单季销售收入达 30.06 亿美元，环比增长 20%，首次突破 30 亿美元。毛利率 25.3%，环比增加 5.2 个百分点，超出预期。业绩增长来自晶圆销量增加 (286.95 万片，环比 + 14.4%)、ASP 环比提升 5.7% 及产品组合优化，涨价因素对毛利率贡献大于产能优化。产能利用率升至 93.7%，持续逼近满产。月产能增至 109.65 万片 (折合 8 英寸)，12 英寸收入占比 78.2%。管理层明确指出 AI 产业推动与溢出效应持续，是配套芯片需求激增的核心驱动力。Q3 收入指引环比 + 2% 至 4%，毛利率 26% 至 28%。



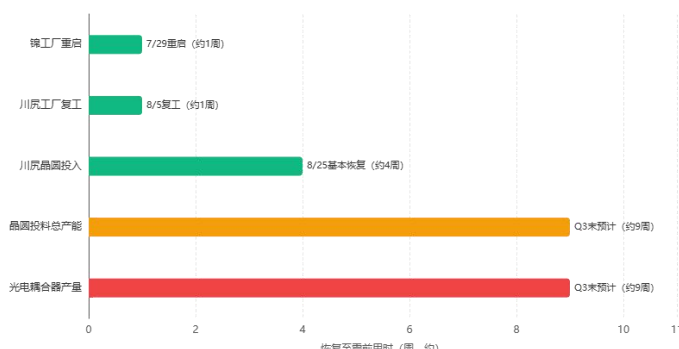
● 英伟达：Q2 营收 962 亿美元同比翻倍，Q3 指引首破千亿

英伟达 2027 财年 Q2 营收 962.21 亿美元（同比+106%，环比+18%），超预期 40 亿，连续 13 季新高，净利润 596.88 亿（+126%），毛利率 75%。数据中心收入 890 亿美元（+117%），其中超大规模 487.1 亿。Q3 营收指引 1080 亿美元，超市场预期 30-40 亿，黄仁勋罕见给出 2028 财年约 70%增速指引（市场预期约 45%）。受 Memory 成本上涨影响，部分 AI 服务器制造商通知大型云客户，搭载 NVIDIA AI 芯片的服务器报价或上涨逾 15%。



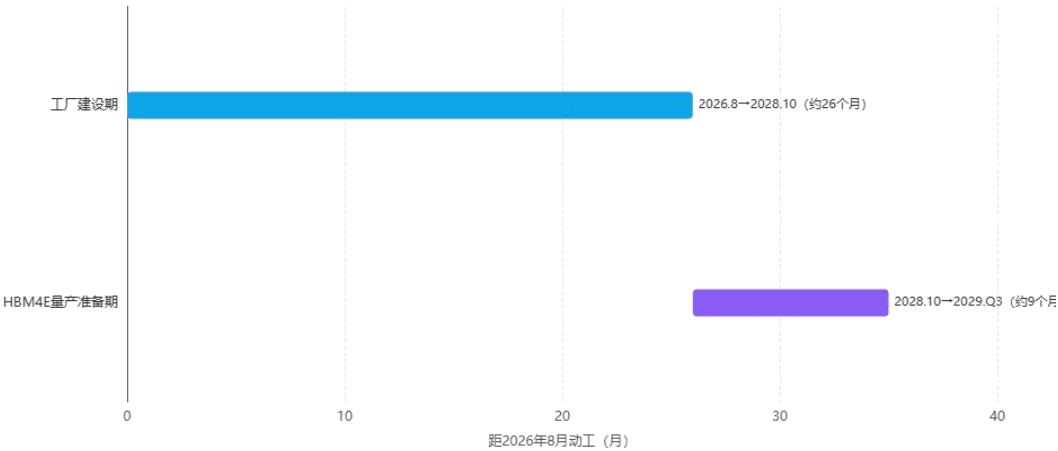
● 瑞萨电子：熊本地震余波持续，光电耦合器与车规 MCU 生产受限

7 月末熊本地震后，瑞萨电子旗下两座工厂分阶段复产：锦工厂于 7 月 29 日起陆续重启，川尻工厂自 8 月 5 日起分批复工。按瑞萨官方口径，川尻工厂复产后约三周内恢复震前晶圆投入水平；据 8 月 25 日媒体报道，其晶圆投入能力已基本恢复至震前水平。不过，晶圆投料总产能与光电耦合器产量仍预计要到第三季度末才能全面恢复，市场恐慌性采购态势短期内仍将持续。光电耦合器产线尚处于停工或缓慢恢复状态，车规级 MCU（RL78、RH850 系列）积压订单大幅延期，对下游汽车与工业客户的交付形成持续扰动。



● **SK 海力士：美国工厂 2029 年 Q3 量产 HBM4E，CEO 预测供不应求持续至 2030 年底**

2026 年 8 月 27 日，SK 海力士在美国印第安纳州西拉斐特举行下一代高带宽内存（HBM）先进封装厂动工仪式。该项目总投资超过 40 亿美元，计划于 2028 年 10 月完成洁净室建设，并于 2029 年下半年正式启动第七代 HBM4E 的量产。建成后将成为美国境内首个实现 HBM 量产（HBM4E）的工厂。SK 海力士 CEO 郭鲁正对市场前景作出判断，全球内存芯片短缺预计将持续到 2030 年年底，而供应过剩的风险很低，因为在 AI 时代，内存芯片已不再是“单纯的标准化商品”。



三、终端市场动态

终端市场动态概览		
类别	动态	洞察
人工智能	全球四大科技巨头持续上调 AI 数据中心资本支出，未来数年合计投资承诺已达 2.4 万亿美元量级。	2.4 万亿美元投资意味着 AI 服务器、交换机、光模块、电源模块及被动元件需求将在未来 3—5 年持续高位。
	集邦咨询预计 2026 年全球九大云端服务供应商（CSP）总资本支出将同比大涨约 90%，同时将全球 AI 服务器出货增速上调至 31%。	AI 服务器出货增速 31% 将同步拉动服务器主板、GPU 加速卡、HBM、高速光模块、高多层 PCB 及电源模块需求。
	CoreWeave 将 2026 年资本支出指引上调至 350—390 亿美元；宣布在印尼建设总容量 360MW 的三个数据中心，进军东南亚 AI 云市场。	AI 算力需求不仅限于四大巨头，GPU 服务器、HBM、高速网络设备和液冷系统的需求面持续扩大。
汽车	特斯拉得州布鲁克希尔 50GWh 储能工厂正式投产，Megapack 3 下线，从动土到出货仅 16 个月。	50GWh 储能产能投产将大规模拉动 BMS 芯片、IGBT/SiC 功率模块、电流 / 电压传感器、继电器和连接器需求。
机器人	小鹏在业绩会上公布 IRON 人形机器人计划：2026 年底规模量产，2027 年面向零售和服务行业商业化发售，月产能可提升至数千台。	车企跨界造机器人将复用汽车电子供应链（MCU、功率器件、传感器、连接器），同时新增机器人专属器件需求，月产能数千台意味着核心元器件年采购量达数万至数十万件。
	优必选与基本半导体签署战略合作，联合开发人形机器人专用 SiC 功率器件方案，聚焦电源管理和运动控制。	机器人专用 SiC MOSFET、驱动 IC 和无源元件的增量需求将持续释放。
工业	西门子宣布在美佐治亚州和得州新建两座工厂，投资超 2 亿美元，专门供应 AI 数据中心电力基础设施。	持续拉动工业功率器件和电力电子元器件需求，如 IGBT/SiC 功率器件、电流 / 电压传感器、继电器、接触器和温控芯片等。

（一）人工智能

● 四大科技巨头未来数年 AI 基建投资承诺逼近 2.4 万亿美元

谷歌母公司 Alphabet、Meta、微软和亚马逊已为未来数年的数据中心建设承诺投入近 2.4 万亿美元，以加码人工智能基础设施竞赛。监管文件显示，Alphabet 相关采购承诺与租约总额达 9020 亿美元，Meta 未来支出接近 7000 亿美元。尽管自由现金流面临压力，但受庞大的人工智能算力需求驱动，四大头部公司仍相继上调支出计划。

其中，亚马逊今年资本支出升至 2200 亿美元，云计算业务营收同比增长 37%。

- **2026 年九大 CSP 资本支出将大涨 90%，AI 服务器出货将增长 31%**

TrendForce 报告显示，受 AI 基建需求推动，预计 2026 年全球九大 CSP 总资本支出同比增约 90%，2027 年将达 1.3 万亿美元（增幅 49%）。因超大型 CSP 及 Tier-2 对英伟达整柜式方案采购意愿提高，谷歌、AWS 新 ASIC 平台下半年放量，加之中国大陆业者扩大本地 AI 方案，TrendForce 将 2026 年 AI 服务器出货年增率由 28%上调至 31%。

- **CoreWeave 将 2026 年资本支出上调至 350—390 亿美元，进军印尼建 360MW 数据中心**

CoreWeave 发布 Q2 财报，将 2026 年全年资本支出指引从 310—350 亿美元上调至 350—390 亿美元。Q2 单季资本支出 94 亿美元，Q3 指引 115—135 亿美元。公司拥有超过 1GW 的美国境外签约电力，采用液冷和高速互联架构。8 月 4 日 CoreWeave 宣布计划在印度尼西亚建设三个新数据中心，总容量 360MW，投资数十亿美元，预计 2028 年投入运营，目标客户为东南亚实验室、初创企业和企业客户。

（二）汽车

- **特斯拉 Megapack 3 量产下线，德州超级工厂年产能 50GWh**

特斯拉 Megapack 3 在美国德克萨斯州布鲁克希尔超级工厂正式量产，该工厂从动工到投产仅 16 个月，年产能 50GWh，主供北美市场。至此，特斯拉全球三座 Megafactory 总产能达 110GWh（加州 40GWh、上海 20GWh、德州 50GWh）。Megapack 3 单机容量 5MWh，模块化设计，内置变压器和开关设备，大幅简化现场施工。产品支持最长 8 小时应用，采用碳化硅 PCS 和新消防系统，热管理借鉴 Model Y 热泵，连接数量减少 78%，显著降低故障率。

(三) 机器人

- **小鹏 IRON 人形机器人年底规模量产，2027 年面向零售和服务行业发售**

小鹏汽车在业绩会上公布 IRON 人形机器人量产时间表：计划 2026 年底进入规模量产，率先在公司门店和园区落地应用；2027 年正式面向零售和服务行业客户发售，实现海内外规模化交付，月产能可根据市场需求提升至数千台。小鹏研发人形机器人已有 8 年，何小鹏表示高阶人形机器人的技术挑战和创新难度远高于智能汽车，“至少相差 20 倍”。小鹏广州知识城超级工厂已实现“纯电 + 飞行汽车”双线并行，为机器人量产提供制造基础。

- **优必选与基本半导体签署 SiC 功率器件合作，联合开发人形机器人专用电源管理和运动控制方案**

优必选（UBTECH）与基本半导体（BASiC Semiconductor）签署战略合作协议，双方将在具身智能人形机器人的碳化硅（SiC）功率器件应用领域展开深度合作。核心内容包括：联合开发面向人形机器人的高性能、高可靠性 SiC 功率器件方案，重点聚焦电源管理系统和运动控制系统。优必选管理层将 Walker S 系列全年出货目标从 2,000-3,000 台上调至 5,000 台，SiC 功率器件将用于机器人关节驱动和电源转换模块，以提升能效和功率密度。人形机器人正从传统硅基 MOSFET/IGBT 向 SiC 方案迁移，SiC 可降低开关损耗 30% 以上，延长电池续航。

(四) 工业

- **西门子投资超 2 亿美元在美新建两座工厂，扩产 AI 数据中心电力设备**

西门子宣布，在美国佐治亚州彭德格拉斯和得克萨斯州大草原城新建两座制造工厂，投资总额超过 2 亿美元。佐治亚州工厂将生产低压（low voltage）电气基础设施产品和系统，得州工厂将为开关设备工厂提供测试和仓储扩展，这些设备是 AI 数据中心电力基础设施的核心组成部分。西门子表示，AI 数据中心的电力需求正从“兆瓦级”向“吉瓦级”跃升，传统电网设备产能已无法满足需求，必须新建专用产线。西门子此前已与英伟达合作开发面向下一代 AI 服务器的配套供电解决方案，施耐德电气也有类似布局。

四、存储行情

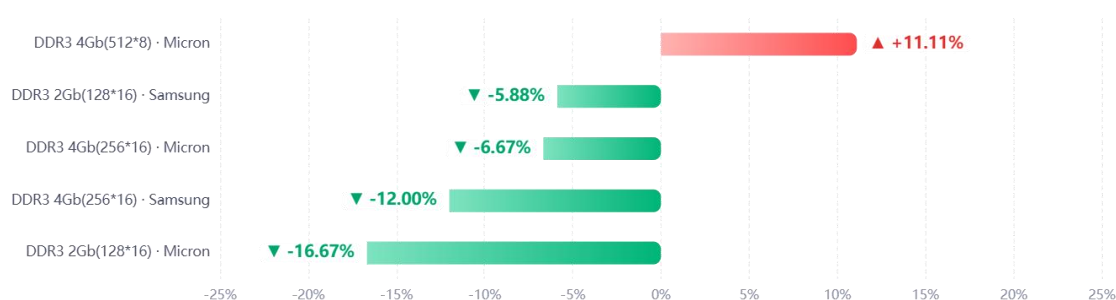
(一) 存储行情概览

- **DRAM:** TrendForce 预计 Q3 传统 DRAM 合约价环比上涨 13%至 18%，而摩根士丹利、瑞银等外资行预测 Q3 涨幅可达 20%至 32%。
- **DDR3:** 延续供应紧张态势，价格持续上行，但现货涨幅已有所放缓。
- **DDR4:** 合约走强（Q3 或涨约 50%），部分现货已出现松动回调。
- **DDR5:** 受成本与云采购双驱动，价格维持高位。
- **HDD:** AI 存储需求推动价格持续上行，供应缺口预计延续至 2028 年。

(二) 存储品类/品牌现货市场价格趋势

● DRAM 颗粒 (DDR3)：整体企稳，窄幅震荡

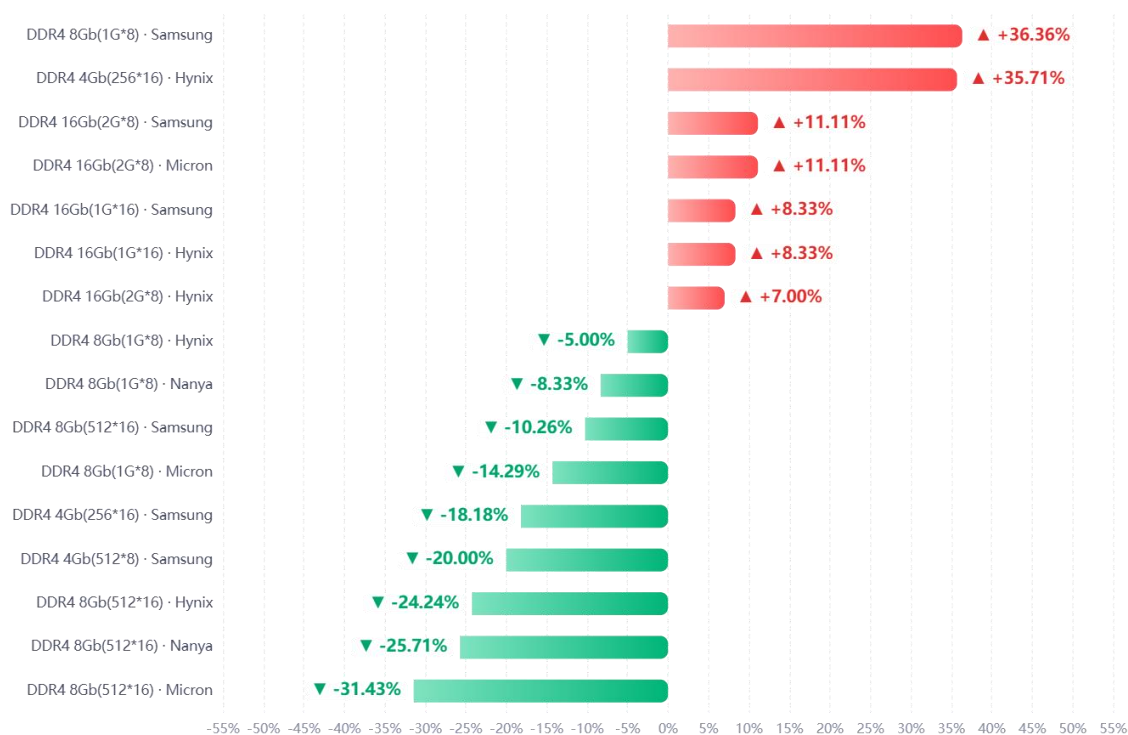
- DDR3 颗粒本月整体进入平稳期，绝大多数规格价格与上月持平，仅个别低容量规格出现小幅调整，市场供需趋于均衡。



△ DRAM 颗粒 · DDR3 · 涨跌幅排行 (%) — 7 月至 8 月各型号涨跌幅排名，右涨左跌

● DRAM 颗粒 (DDR4)：高容量普涨、低容量走弱，分化明显

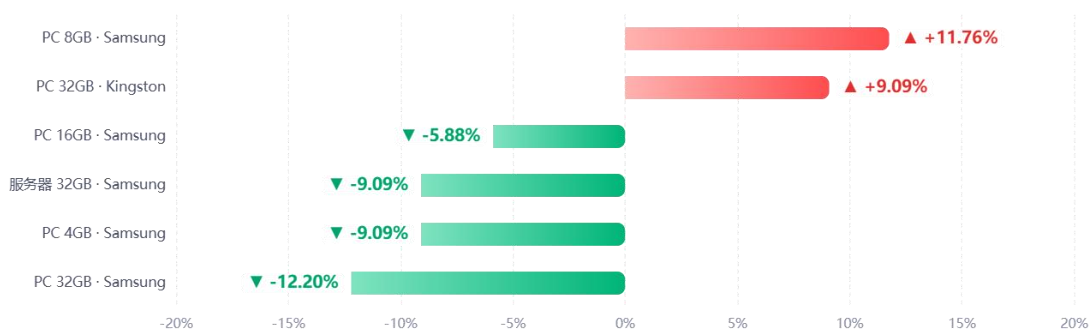
- DDR4 颗粒本月呈明显的“两头分化”：大容量颗粒受 AI 服务器与数据中心扩容需求拉动普遍上涨，且涨幅居全榜前列；中低容量颗粒则因供需宽松普遍承压下行，个别规格跌幅较深。



△ DRAM 颗粒 · DDR4 · 涨跌幅排行 (%) — 7 月至 8 月各型号涨跌幅排名，右涨左跌

● DDR4 内存条：跌多涨少，价格中枢下移

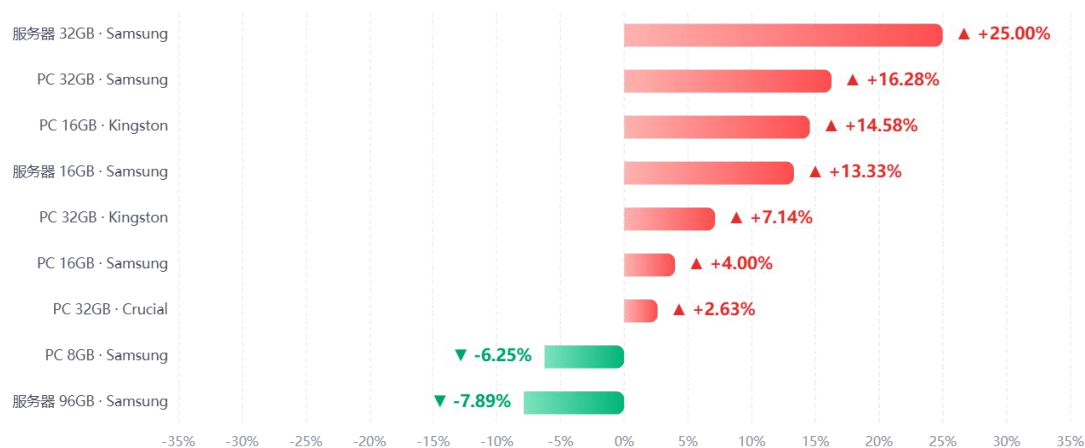
- DDR4 内存条本月变动的型号跌多涨少。随着 DDR5 在服务器与 PC 端的渗透率持续提升，DDR4 需求进入收缩通道，价格中枢稳步下移。



△ DDR4 内存条 · 涨跌幅排行 (%) — 7 月至 8 月各型号涨跌幅排名，右涨左跌

● DDR5 内存条：需求旺盛，主流容量普涨

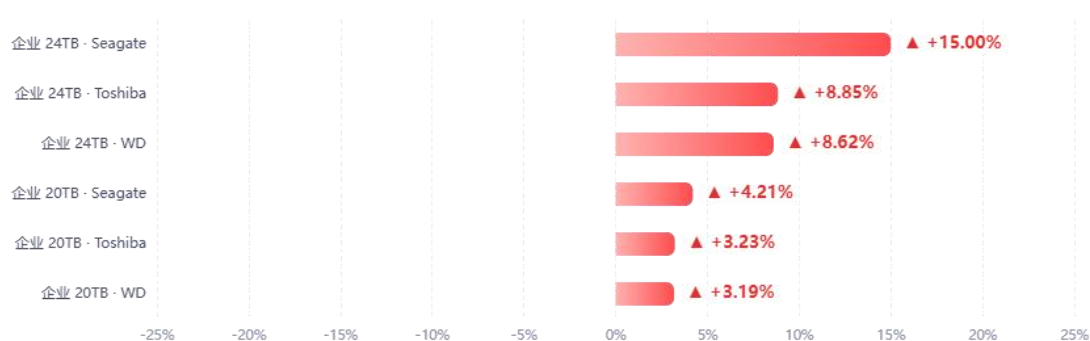
- DDR5 内存条上涨集中在主流通用容量，行业头部品牌全线领涨，反映其在产能与议价上的优势；仅少数高位大容量规格出现回调。AI 服务器与新一代 PC 平台放量持续带动 DDR5 需求，短期价格仍具上行动力。



△ DDR5 内存条 · 涨跌幅排行 (%) — 7 月至 8 月各型号涨跌幅排名，右涨左跌

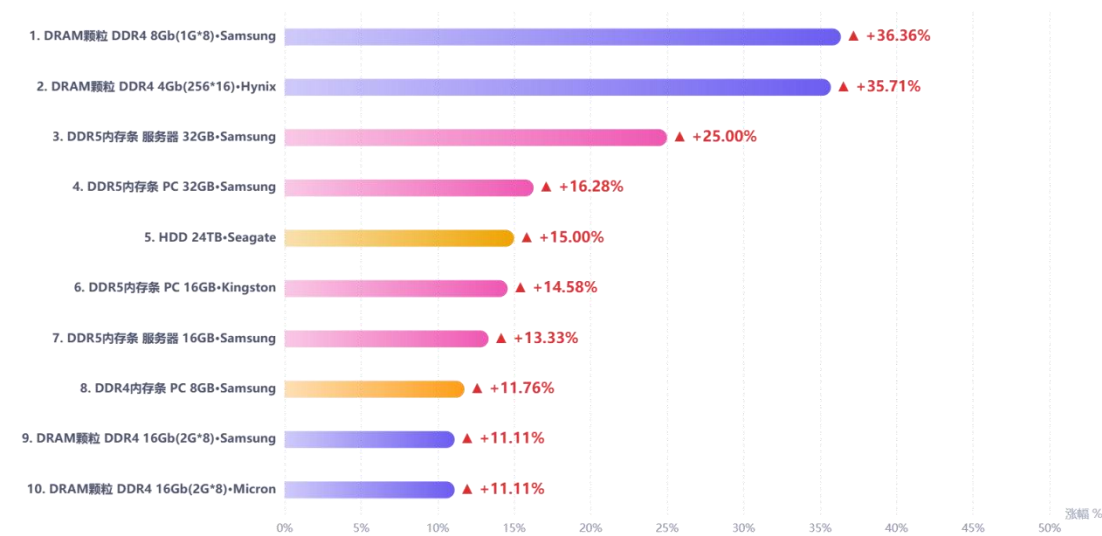
● HDD：大容量领涨，价格易涨难跌

- HDD 本月涨幅由大容量产品驱动：高容量型号全线普涨并领跑全榜，中等容量小幅跟涨，低容量则全部持平。AI 大模型训练与云服务对冷数据、大容量归档存储的需求持续走高，高容量 HDD 供需偏紧、价格易涨难跌。



△ HDD · 涨跌幅排行 (%) — 7 月至 8 月各型号涨跌幅排名，右涨左跌

● 8月涨幅 TOP10 总排行榜



△ 按 7→8 月涨幅排名，右侧数字为 7 月至 8 月的涨幅

*以上数据截至 2026 年 8 月，受市场供需影响，价格浮动明显，数据仅作参考

信息来源

- [1] 優分析產業數據中心, 【意法半導體再傳漲價】需求回來、產能又在轉換, 拆解 MCU 供應吃緊原因, 2026.08.21
- [2] 华尔街见闻, 新一轮半导体涨价潮将至! 意法半导体拟于 8 月 23 日宣布提价, 2026.08.21
- [3] 东方财富网, 半导体现新一轮涨价潮 意法半导体、卓胜微等密集调价, 2026.08.31
- [4] 半导体器件应用网, 恩智浦二季报出炉, 净利大涨 72%! , 2026.8.01
- [5] Smile, NXP 两月内两次提价, ST 跟涨释放供给紧张信号, 2026.08.13
- [6] 恩投資財經網, 《科技》搶攻智慧工廠商機 恩智浦 MCX A5 強化邊緣裝置連接力, 2026.08.24
- [7] 观点网, 豪恩汽电加入 ASA-ML 生态 携手微芯科技推进座舱及 ADAS 连接标准化, 2026.08.26
- [8] 第 e 理财网, 瑞薩車用晶片工廠產能恢復至地震前水準, 2026.08.25
- [9] 电子产品世界, ADI FY2026 Q3: 营收首破 40 亿美元, 把 AI 数据中心机会定义为 “grid-to-chip” , 2026.08.20
- [10] 半导体器件应用网, 41.7 亿, 英飞凌 AI 电源业务起飞!, 2026.08.6
- [11] 全球半导体观察, 市场 | 全线调涨 30%, MLCC 提价风暴, 愈演愈烈! , 2026.08.03
- [12] 格隆汇, “全力生产也跟不上需求”, 美光 CEO 称数据中心需求高出产能 50%, 2026.08.26
- [13] 財報狗, 美光砸 3000 億元押注 AI 記憶體 宣布十年百億美元打造研究中心, 2026.08.21
- [14] 南方财经网, 订单爆满! 台积电先进封装 CoWoS 产能供不应求, 全球封测行业量价齐升 | 盘中雷达, 2026.08.19
- [15] 集微网, 台积电 CoWoS 先进封装产能告急: 订单外溢英特尔打破生态惯例, 2026.08.21
- [16] 橙芯世界, 索尼台积电签最终协议, 7470 亿日元熊本合资, 2029 年量产先进传感器, 2026.08.13
- [17] 证券时报网, 涨价超过 15%! 人工智能芯片巨头, 爆出大消息! 影响多大? , 2026.08.23
- [18] NVIDIA, NVIDIA Groq 3 LPX Now in Full Production With World-Class

Speed for Agentic AI, 2026.08.24

[19] 界面新闻, 英伟达创 4 年来最长连跌纪录, 市值一夜蒸发万亿元, 2026.08.26

[20] 新浪财经, AI 基建竞赛持续升温 谷歌(GOOG.L.US)、Meta(META.US)、微软(MSFT.US)、亚马逊(AMZN.US)未来承诺投资总额逼近 2.4 万亿美元, 2026.08.01

[21] 上海证券报, 九大云厂商加码资本支出 AI 服务器出货量预期增长, 2026.08.04

[22] 新浪财经, 东海研究 | 电子: 全球 AI 服务器出货增速上调至 31%, AMD 数据中心营收翻倍, 2026.08.12

[23] Whalesbook, CoreWeave Lifts 2026 Spending Forecast to \$39B After Q2 Beat, 2026.08.13

[24] 新浪财经, CoreWeave 计划通过印尼数据中心进军亚洲市场, 2026.08.04

[25] 北极星储能网, Megapack3 下线! 特斯拉美国 50GWh 储能工厂正式投产, 2026.08.07

[26] gmt8press, Lates News, 2026.08.27

[27] 先进半导体晶体材料, 基本半导体与优必选达成合作! 碳化硅杀入人形机器人赛道?, 2026.08.25

[28] 网易, 西门子 2 亿美元投资美国制造业, 为 AI 数据中, 2026.08.09

[29] 同花顺 inews, 券商观点|电子行业点评报告: 存储涨价持续兑现, 原厂业绩验证景气上行, 2026.08.07

[30] 太平洋科技, 内存厂忙着造 HBM DDR4 没人管了! 三季度还要再涨 50%, 2026.08.19

[31] 电子发烧友网, 涨幅 219%!DDR3 价格反超 DDR5, 工控硬件遭遇存储供给变局, 2026.08.27

[32] AMD Investor Relations, AMD Reports Second Quarter 2026 Financial Results, 2026.08.04

[33] 新浪财经, AMD 盘后大跌超 9%!Q2 营收利润均超预期 Q3 指引未满足乐观投资者预期, 2026.08.05

[34] 华尔街见闻, 博通电话会: 2027 年 AI 芯片营收将破 1000 亿美元, 2026.08.25

[35] ZAKER 新闻, 博通重申 2027 年 AI 营收破千亿 六大客户撑起半壁江山, 2026.08.27

[36] 中芯国际, 中芯国际发布 2026Q2 财报 单季销售收入首次突破 30 亿美元, 2026.08.13

- [37] 新浪财经, 中芯国际第二季度业绩出炉 财报透露这些信号, 2026.08.13
- [38] NVIDIA Newsroom, NVIDIA Announces Financial Results for Second Quarter Fiscal 2027, 2026.08.26
- [39] 英伟达博客, NVIDIA 发布 2027 财年第二季度财务报告, 2026.08.26
- [40] 全天候科技, 英伟达上季营收超预期翻倍大增 本季料首破千亿大关, 2026.08.27
- [41] 电子产品世界 (经新浪财经), Renesas 川尻工厂恢复至震前晶圆投入能力, 2026.08.25
- [42] 新浪财经, 熊本地震后半导体工厂集中复产! 瑞萨、索尼分阶段复工, 台积电熊本厂恢复运行, 2026.08.04
- [43] DIGITIMES, 瑞萨熊本 2 厂提前复工 产能估 8 月底全面恢复, 2026.08.05
- [44] 芯资讯, 官宣! 台积电与索尼成立合资公司! , 2026.8.11
- [45] WSTS, Global Semiconductor Market records exceptional growth in Q2 2026. 2026.08.06
- [46] 启元洞见, AI 安全快讯 0803 | 欧盟就人工智能模型入侵事件约谈 OpenAI 与 Anthropic, 2026.08.3
- [47] 每日经济新闻, 最新发布! 8 月份, 中国制造业 PMI 为 49.8%, 比上月上升 0.6 个百分点, 景气水平回升, 2026.08.31
- [48] 搜狐, 【奥伟斯 OWEIS】最新消息, 德州仪器开启本年度第四轮涨价, 10 月 1 日执行! , 2026.08.12
- [49] 每日经济新闻, 特朗普宣布对多晶硅及其衍生产品加征关税, 多晶硅、太阳能电池等设置最低进口价格, 2026.08.07
- [50] 安泰科, 从贸易限制到供应链重构——美国多晶硅 232 关税措施评析, 2026.08.28
- [51] 韩联社, 南韓 8 月出口 982.5 億美元 為單月第三高, 2026.09.01
- [52] BT 财经, 韩国 8 月出口暴增 68.7%: 466 亿美元卖芯片, 汽车跌近三成, 2026.09.01
- [53] 博思财经, AI 点火亚洲製造业中日韩台景气 8 月齐旺, 2026.09.01
- [54] 韩联社, SK 海力士在美举行 HBM 先进封装厂动工仪式, 2026.08.28
- [55] 金十数据, SK 海力士 CEO: 内存芯片短缺将持续至 2030 年, 2026.08.30
- [56] TrendForce, 【洞察】内存现货价格更新: DRAM 现货价格涨幅放缓, 而 DDR4 和 DDR3 继续上涨, 2026.08.05

免责声明

安芯易电子商务（深圳）有限公司(下称“安芯易公司”)所发布的月度报告由安芯易公司市场部基于现已公开的资料、信息、研究报告等进行整理编制而成。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映安芯易公司在报告发布当期的判断、观点，仅供学习参考之用，不构成对所述产品的出价、征价、要约或要约邀请，不构成任何合同或承诺的基础，不构成买卖任何投资工具或者达成任何交易的推荐，亦不构成任何投资、采购及其他应用建议和指导，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行交易、投资所造成的一切后果或损失，安芯易公司不承担任何法律责任。因此，读者在阅读本报告时应保持警惕，并进行独立的判断和分析。

安芯易公司对本报告中所引用的资料、研究报告所涉及的或从第三方媒体获得的信息及数据的真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示或默示的保证。所发布的信息、观点以及数据有可能因发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，但安芯易公司不承担更新不准确或过时的信息、观点以及数据的义务，在对相关信息进行变更或更新时亦不会另行通知。

该报告版权归安芯易公司及相关内容提供方所有，未经授权，任何人不得以任何方式转载、修改、翻版、分发、复制、发表。

安芯易电子商务（深圳）有限公司

2026 年 8 月

360iC 安芯易



安芯易隶属于Ample Solutions集团,成立于2008年,在全球拥有7个办公室,专注于为全球电子制造业客户提供元器件全球采购及供应链服务。我们始终秉持“专注、专业、坚韧、谦卑”的核心价值观,为客户提供卓越服务,助力客户成功。

我们拥有100+资深采购专家,并与来自全球的10000+供应商建立合作,致力于以更快的速度,更低的成本,为客户解决元器件供应链问题。

在深圳和香港,我们建立了两个高标准品质控制中心,严格遵循国际品质控制体系。从供应商管理到品质检测,全方位地防范风险,确保客户的元器件供应链安全和稳定。

